



All-in-one

## APPLE IMAC 27" MC813

Détails de la notation :

<b>C+</b>	NOTE RSE	>
<b>D-</b>	NOTE CYCLE DE VIE	>
<b>F+</b>	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Gamme de prix

# 1000 – 2000 €

Le All-in-One iMac 27" MC813 de APPLE est équipé du processeur Intel Core i5, de la carte graphique Non-communicé et possède une mémoire vive de 4 Go.

Il est labellisé EPEAT et Energy Star .



EPEAT



ENERGY STAR

## MATURITÉ RSE



**C+**

Apple propose deux rapports complémentaires permettant d'avoir un visuel de son implication dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Bien que le suivi depuis le début de la décennie soit clair, il est difficile d'identifier les ambitions de l'entreprise pour les années à venir. Soulignons toutefois l'engagement d'Apple dans le recyclage de ses produits ou encore dans les énergies renouvelables avec, par exemple, la reconnaissance de son implication par Greenpeace dans son rapport annuel Click Clean. De manière générale, Apple profite d'une couverture médiatique assez large profitant à son image de marque. Toutefois, les nouvelles ne sont pas toujours positives, mais son implication dans le Développement Durable mérite quand même d'être mis en avant.

## CYCLE DE VIE



**D-**

**3 ans**

De garantie

**0 an**

De disponibilité des pièces

## LES PLUS

- Ne contient pas de PVC dans les parties extérieures du produit
- Ne contient pas de mercure dans les sources de lumière
- Est exempt de Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés
- Ne contient pas de PVC dans l'électronique du produit
- Ne contient pas de PVC dans l'emballage

## LES MOINS

- Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans la coque externe
- Contient 0% de plastique recyclé
- Contient 0% de bioplastique
- Contient 0% de plastique recyclé dans son emballage
- Ne possède pas un emballage monomatière

## EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Masse de la RAM (Go)	<b>4</b>
Masse de la Mémoire Flash (Go)	<b>Non-communicé</b>
Masse de la carte mère	<b>Non-communicé</b>
Part de plastiques recyclés dans le produit (%)	<b>0</b>
Part de bioplastiques dans le produit (%)	<b>0</b>
Masse du microprocesseur + masse de la carte graphique ou la surface de silicium dans le microprocesseur la carte graphique	<b>Non-communicé</b>
Poids (kg)	<b>13.8</b>

## FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit	<b>Non-communicé</b>
---	----------------------

## DISTRIBUTION

Part de carton recyclé dans l'emballage (%)	<b>35</b>
Part de plastique recyclé dans l'emballage (%)	<b>0</b>
Monomatière dans l'emballage	<b>Non</b>

---

Emballage sans PVC	<b>Oui</b>
--------------------	------------

## UTILISATION

---

Emission de COV (mg/h)	<b>Non-communicé</b>
------------------------	----------------------

---

Limitation des champs électromagnétiques créés par le produit	<b>Non-communicé</b>
---	----------------------

---

## DURÉE DE VIE EN PARC

---

Durée de garantie (année)	<b>3</b>
---------------------------	----------

---

Disponibilité des pièces dans le temps (année)	<b>0</b>
--	----------

---

## FIN DE VIE

---

Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires	<b>Non</b>
---	------------

---

Identification des plastiques	<b>Oui</b>
-------------------------------	------------

---

Contient des substances REACH	<b>Non</b>
-------------------------------	------------

---

Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	<b>Non</b>
---	------------

---

Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	<b>Oui</b>
---	------------

---

Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	<b>Non</b>
--	------------

---

Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	<b>Non</b>
---	------------

---

Contient du PVC dans l'électronique	<b>Non</b>
-------------------------------------	------------

---

Présence de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capots	<b>Non</b>
---	------------

---

Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012	<b>Non</b>
--	------------

---

Extension ou échange de la mémoire possible	<b>Oui</b>
---	------------

---

Possibilité d'échange ou d'extension de la capacité de stockage	<b>Oui</b>
---	------------

---

Parties et étiquettes facilement séparables	<b>Oui</b>
---	------------

---

Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables **Oui**

Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles **Oui**

## CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



**F+**

**140 W**

Consommation en marche (W)

**1.36 W**

Consommation en veille (W)

Dispositif d'économie d'énergie **Non**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Carte graphique intégrée **Non-communicé**

Nom de la carte graphique **Non-communicé**

Taille du disque dur **1000**

Type de disque dur **SATA**

Type de RAM **DDR3**

Type de processeur **Intel Core i5**

Cadence du processeur (GHz) **2,7**

Dimensions HxLxP (mm) **510 x 650 x 200**

Taille écran (pouce) **27**

Ecran tactile **Non**